

2016年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2016) セッションプログラム

【第1日:8月31日】

	A室	B室	C室	D室	1F, 2F
9:00	加工機械・要素技術の高性能・高機能化(1)	ツールイング・ドレッシング技術	マイクロ・ナノ加工(1)	ラッピング・ポリシングの原理と応用(1)	パネル・カタログ展示
9:20					
9:40	休 憩				
10:00	加工機械・要素技術の高性能・高機能化(2)	研削現象の基礎とモニタリング(1)	マイクロ・ナノ加工(2)	ラッピング・ポリシングの原理と応用(2)	
10:20					
10:40	休 憩				
11:00	昼 食				
11:20	我が社の新技術発表会 (A棟401室)				
11:40	休 憩				
12:00	高性能切削工具の開発と応用(1)	研削現象の基礎とモニタリング(2)	マイクロ・ナノ加工(3)	光・ビームによる加工技術(1)	
12:20					
13:00	休 憩				
13:20	高性能切削工具の開発と応用(2)	研削現象の基礎とモニタリング(3)	先端加工	光・ビームによる加工技術(2)	
13:40					
14:00	休 憩				
14:20	学会活性化フォーラム (講堂)				
14:40	休 憩				
15:00	休 憩				
15:20	休 憩				
15:40	休 憩				
16:00	休 憩				
16:20	休 憩				
16:40	休 憩				
17:00	休 憩				
17:20	休 憩				
17:30	休 憩				
17:40	休 憩				
17:50	休 憩				
18:00	休 憩				
18:10	休 憩				
18:20	休 憩				
18:30	休 憩				
18:40	休 憩				
18:50	休 憩				
19:00	休 憩				
19:10	休 憩				
19:20	休 憩				
19:30	休 憩				
19:40	休 憩				
19:50	休 憩				
20:00	休 憩				

【第2日:9月1日】

	A室	B室	C室	D室	1F, 2F
9:00	難削材・新素材の加工(1)	超音波・振動援用加工(1)	ナノ精密・ELI D加工	切断・割断加工	パネル・カタログ展示
9:20					
9:40	休 憩				
10:00	難削材・新素材の加工(2)	超音波・振動援用加工(2)	半導体・液晶材料などの加工・計測技術	噴射・ノズル加工の最前線(1)	
10:20					
10:40	休 憩				
11:00	台湾磨粒加工学会招待講演 (A棟401室)				
11:20	休 憩				
11:40	特別講演 (A棟401室)				
12:00	休 憩				
12:20	休 憩				
12:40	活動報告会・贈賞式 (A棟401室)				
13:00	休 憩				
13:20	休 憩				
13:40	休 憩				
14:00	休 憩				
14:20	休 憩				
14:40	休 憩				
15:00	休 憩				
15:20	休 憩				
15:40	休 憩				
16:00	休 憩				
16:20	休 憩				
16:40	休 憩				
16:50	休 憩				
17:00	休 憩				
17:10	休 憩				
17:20	休 憩				
17:30	休 憩				
17:40	休 憩				
17:50	休 憩				
18:00	休 憩				
18:10	休 憩				
18:20	休 憩				
18:30	休 憩				
18:40	休 憩				
18:50	休 憩				
19:00	休 憩				
19:10	休 憩				
19:20	休 憩				
19:30	休 憩				
19:40	休 憩				
19:50	休 憩				
20:00	休 憩				

【第3日:9月2日】

	A室	B室	C室	D室	1F, 2F
9:00	環境調和型加工技術(1)	超砥粒砥石・高機能工具の開発と応用(1)	超精密加工装置の開発と超精密加工技術	噴射・ノズル加工の最前線(2)	パネル・カタログ展示
9:20					
9:40	休 憩				
10:00	環境調和型加工技術(2)	超砥粒砥石・高機能工具の開発と応用(2)	新デバイスへの応用(1)	噴射・ノズル加工の最前線(3)	
10:20					
10:40	休 憩				
11:00	奨励賞受賞記念講演 (A棟401室)				
11:20	昼 食				
11:40	先進切削加工技術(1)	磁界・電界砥粒制御による次世代加工技術	新デバイスへの応用(2)	噴射・ノズル加工の最前線(4)	
11:50					
12:00	休 憩				
12:20	先進切削加工技術(2)			噴射・ノズル加工の最前線(5)	
12:30					
12:40	休 憩				
12:50	休 憩				
13:00	休 憩				
13:10	休 憩				
13:20	休 憩				
13:30	休 憩				
13:40	休 憩				
13:50	休 憩				
14:00	休 憩				
14:10	休 憩				
14:20	休 憩				
14:30	休 憩				
14:40	休 憩				
14:50	休 憩				
15:00	休 憩				
15:10	休 憩				
15:20	休 憩				
15:30	休 憩				
15:40	休 憩				
15:50	休 憩				

2016年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2016)

第1日目(8月31日) (*セッション名後はオーガナイザ名)

A室		B室	
9:00	A01 【加工機械・要素技術の高性能・高機能化(1)】 (廣垣俊樹, 由井明紀, 三浦弘幸) 座長: 三浦弘幸 (ジェイテクト) ダイレクトドライブモータを採用した工作機械の旋回軸の基本性能とオートサーボチューニング 池上貴一, 廣垣俊樹, 青山栄一 (同志社大学)	B01 【ツルーイング・ドレッシング技術】 (久保明彦, 岩井 学, 市田良夫, 吉原信人) 座長: 久保明彦 (北見工業大学) 微粉ドライアイスプラストによるカーボン研削砥石の目詰まり切りくず除去法 —第1報: 最適プラストノズルパスの検討— 太田佑樹, 大橋一仁 (岡山大学)	
9:20	A02 多軸制御加工機の円錐台加工精度測定 井原之敏, 辻 和孝, 田島 徹 (大阪工業大学)	B02 遷移金属電極によるPCDの放電加工性能 —第2報: 除去機構の推定— 岩井 学, 佐々宏賢 (富山県立大学), 鈴木 清 (鈴木清新加工技術研究所)	
9:40	A03 切削トルクの予測結果と実測結果の比較に基づく加工異常検出システムの提案 立川宗治, 西田勇, 佐藤隆太, 白瀬敬一 (神戸大学)	B03 UVツルーイングによるダイヤモンド砥石の研削性能の向上と寿命評価 柴元翔太郎 (熊本大学), 坂本武司 (有明工業高等専門学校), 久保田章亀, 峠 睦 (熊本大学)	
10:00	A04 閉回路型静圧すべり案内の紹介 多田敦司 (東芝機械), 新井貴雄 (ニューリー研究所), 相良 誠, 宮本拓磨 (東芝機械)	B04 石英ツルーイングしたCBN軸付砥石の研削性能評価とツルーイングメカニズムの解明 宮本竜成 (熊本大学), 峠 直樹 (ノリタケカンパニーリミテド), 坂本武司 (有明工業高等専門学校) 久保田章亀, 峠 睦 (熊本大学)	
10:20	***** 休憩 *****		
10:40	A05 【加工機械・要素技術の高性能・高機能化(2)】 座長: 井原之敏 (大阪工業大学) 長尺内面研削スピンドルの開発に関する研究 —第六報、小径深穴加工物の試研削時の振動解析— 安達和彦 (中部大学), 大久保信雄, 大久保元博 (大久保精工), 向井良平, 高橋宏美 (豊幸)	B05 【研削現象の基礎とモニタリング(1)】 (大橋一仁, 水谷秀行, 坂本治久, 李 和樹) 座長: 大橋一仁 (岡山大学) 画像処理による砥石作業面の3次元解析 —第9報: ラインカメラによる高速画像取得とポロノイ図を用いた砥粒切れ刃分布の解析— 川下智幸, 坂口彰浩, 川口維文, 松井尚督, 前田純弥, 松尾修二 (佐世保工業高等専門学校), 峠 直樹 (ノリタケカンパニーリミテド), 中島昭二 (菱計装)	
11:00	A06 円筒研削盤用主軸台の新冷却法の検討 向井良平, 牧内明, 高橋宏美, 近藤貴則 (豊幸), 清水伸二 (マムテック)	B06 画像処理によるダイヤモンド砥粒の形状計測に関する研究 永島康詞, 磯部良太, 坂口彰浩, 川下智幸, 松尾修二 (佐世保工業高等専門学校), 峠 直樹 (ノリタケカンパニーリミテド), 中島昭二 (菱計装)	
11:20	A07 砥粒切れ刃先端のサブミクロン除去と研削性能 酒井隼樹, 大久保聡, 小野直人 (ジェイテクト)	B07 紫外線光域画像を用いたダイヤモンド砥粒分布の解析 太田航平, 前田純弥, 坂口彰浩, 川下智幸, 松尾修二 (佐世保工業高等専門学校), 峠 直樹 (ノリタケカンパニーリミテド), 中島昭二 (菱計装)	
11:40	A08 研削盤砥石カバーの安全性に関する研究 —ステンレス製カバーに対する衝突実験— 福井拓哉, 佐藤元宣, 山田浩之, 北嶋孝之, 小笠原永久, 由井明紀 (防衛大学校)	B08 砥粒径のばらつきが研削面粗さに与える影響 蛸名雄太郎, 前崎智博, 周 立波, 清水 淳, 小貫哲平, 尾島裕隆, 乾 正知 (茨城大学)	
12:00	***** 昼食 *****		
13:00	我が社の新技術発表会 (A棟401室)		
14:40	***** 休憩 *****		
15:00	A09 【高性能切削工具の開発と応用(1)】 (村上良彦, 矢部和寿, 原田高志) 座長: 原田高志 (住友電工) 微細表面構造による切削工具の高機能化とその構造最適化 杉原達哉, 榎本俊之 (大阪大学)	B09 【研削現象の基礎とモニタリング(2)】 座長: 水谷秀行 (中部大学) 砥粒支持剛性を用いた砥石の接触剛性の算出 山田高三, 李 和樹 (日本大学)	
15:20	A10 焼入れ鋼の仕上げ加工を対象とした駆動型ロータリ加工に関する研究 —高能率化の検討と被膜材種の選定— 渡邊賢太郎, 加藤秀治, 高瀬紀幸 (金沢工業大学), 鈴木直彦 (高松機械), 久保田和幸 (三菱日立ツール)	B10 研削中の工作物熱変形挙動を考慮した知能化研削システムの開発 大西 孝, (岡山大学), 坂倉守昭 (大同大学), 藤山泰弘, 岡上拓央, 大橋一仁 (岡山大学)	
15:40	A11 旋削における工具損耗のフラクタル次元評価 ユザイリ ビン アブドゥル ラヒーム (マレーシアペルリス大学), 清水毅, 萩原親作 (山梨大学)	B11 長尺円筒工作物のトラバース研削のシミュレーション解析 —加工条件と加工精度の関係— 金山裕一, 坂倉守昭 (大同大学), 大西 孝, 高島哲平 (岡山大学)	
16:00	***** 休憩 *****		
16:20	A12 【高性能切削工具の開発と応用(2)】 座長: 加藤秀治 (金沢工業大学) ポロンドープダイヤモンドを利用したPCD工具による難加工材の切削加工 岩井 学, 子林達也 (富山県立大学), Peter Chen, Bear Lin (江信有限公司), 鈴木 清 (鈴木清新加工技術研究所)	B12 【研削現象の基礎とモニタリング(3)】 座長: 李 和樹 (日本大学) ステンレス鋼用ベルト研削油に関する検討 谷野順英, 杉井秀夫 (出光興産), 津田康宏, 君塚弘行 (出光ルプテクノ)	
16:40	A13 レーザ成形したナノ多結晶ダイヤモンド製ノーズR バイトに対する切れ刃鋭利化のためのドライエッチング 天本祥文, 姚 雲校, 仙波卓弥 (福岡工業大学), 角谷 均 (住友電気工業)	B13 積層研磨ホイールの研削における摩耗特性 加茂剛士, 宮本 猛 (神戸市立工業高等専門学校), 塗矢隆彦 (ニートレックス)	
17:00	A14 紫外線照射研磨を用いたPCD製工具の切削性能の改善 後藤健太 (熊本大学), 和泉康夫 (新日本テック), 坂本武史 (有明工業高等専門学校), 久保田章亀, 峠 睦 (熊本大学)	B14 ベルト研削における砥粒分散性のエントロピー的解析 功刀壮崇, 孕石泰文, 清水 毅, 萩原親作 (山梨大学)	
17:20	***** 休憩 *****		
17:30	学会活性化フォーラム「姫路城から次世代ものづくりを学ぶ」 講演:「姫路城はこうしてできた—先端の思想と技術」(講堂) 17:30~19:00 播磨学研究所長/兵庫県立大学 特任教授 中元孝迪 氏		
20:30	交流会(生協食堂) 19:00~20:30		

2016年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2016)

第1日目(8月31日) (*セッション名後はオーガナイザ名)

	C室	D室
9:00	<p>【マイクロ・ナノ加工(1)】(松井伸介, 松村 隆, 江頭 快) 座長: 江頭 快 (京都工芸繊維大学) C01 パルスウオータージェットによる微細加工 (液滴の帯電) 藤原関夫, 渡瀬圭太 (兵庫県立大学)</p>	<p>【ラッピング・ポリシングの原理と応用(1)】(榎本俊之, 清水 淳, 林 偉民) 座長: 畝田道雄 (金沢工業大学) D01 マイクロ波加熱によるエポキシ樹脂研磨パッドの高速製造 山本剛史, 張 宇, 谷 泰弘 (立命館大学)</p>
9:20	<p>C02 高硬度材 (SUJ2) のニアドライ切削加工における工具摩耗特性 鄒 雅寧, 前田幸男, 山田真司 (富山県立大学)</p>	<p>D02 低粘度エポキシ樹脂を用いた研磨パッドの開発 大西弘晃, 張 宇, 谷 泰弘 (立命館大学), 川波多 裕司, 桐野宙治 (クリスタル光学)</p>
9:40	<p>C03 平バイトの切り取り厚さがスクラッチ痕に及ぼす影響 天木恵輔, 飯田智丈, 前田幸男 (富山県立大学)</p>	<p>D03 冷凍ピンチャックを用いた基板保持手順の最適化 吉富健一郎, 多田一生, 宇根篤暢, 餅田正秋 (防衛大学校)</p>
10:00	<p>C04 ボールエンドミルにおける工具振れ回りが加工精度に及ぼす影響とその低減方法 中井 伸, 前田幸男, 五藤大輔 (富山県立大学)</p>	<p>D04 研削シリコンウエハのナノ引っかき 清水 淳, 林 旺稟, 周 立波, 小貫哲平, 尾高裕隆, 山本武幸 (茨城大学)</p>
10:20	***** 休憩 *****	
10:40	<p>【マイクロ・ナノ加工(2)】 座長: 松井伸介 (千葉工業大学) C05 CO2雰囲気を利用した精密加工における炭素鋼の仕上げ面生成に関する研究 宮元省吾, 児玉紘幸, 奥田孝一, 布引雅之 (兵庫県立大学)</p>	<p>【ラッピング・ポリシングの原理と応用(2)】 座長: 清水 淳 (茨城大学) D05 加工液特性がサファイアウエハの研磨加工に与える影響 山本宏一郎, 諏訪部 仁, 石川憲一 (金沢工業大学)</p>
11:00	<p>C06 ニオブ酸リチウムの微細溝加工における仕上げ面性状評価に関する研究 貴志裕治, 児玉紘幸, 奥田孝一, 布引雅之 (兵庫県立大学)</p>	<p>D06 サファイアCMPにおける研磨メカニズムの分析 —スウェード系研磨パッド表面の空孔が研磨レートに与える影響— 畝田道雄, 高野圭市, 伊藤諒平 (金沢工業大学), 坂本昌隆, 小山浩司, 會田英雄 (並木精密宝石), 石川憲一 (金沢工業大学)</p>
11:20	<p>C07 放電加工成形されたダイヤモンド研削工具によるナノスケール微細軸加工 高野英亮, 栗山健一, 佐々木良大, 江頭 快, 山口桂司, 太田 稔 (京都工芸繊維大学)</p>	<p>D07 紫外光援用研磨による単結晶SiC表面の平滑化 久保田章亀, 峠 睦 (熊本大学)</p>
11:40	<p>C08 焼結ダイヤモンド製研削工具を使った超硬合金製マイクロレンズアレイ金型の試作 仙波卓弥, 貝田博典, 天本祥文 (福岡工業大学)</p>	<p>D08 5軸制御マシニングセンタを用いた非球面型の磁気研磨法の開発 古木辰也 (岐阜大学), 廣垣俊樹, 青山栄一 (同志社大学), 小川圭二 (龍谷大学)</p>
12:00	***** 昼食 *****	
13:00	我が社の新技術発表会 (A棟401室)	
14:40	***** 休憩 *****	
15:00	<p>【マイクロ・ナノ加工(3)】 座長: 松村 隆 (東京電機大学) C09 小径パッドによる部分研磨の検討 松井伸介, 青山拓矢 (千葉工業大学)</p>	<p>【光・ビームによる加工技術(1)】(古本達明, 比田井洋史, 細野高史, 池野順一) 座長: 古本達明 (金沢大学) D09 レーザスライシング技術に応用したレーザ切り抜き加工 山田洋平, 金子洋平, 青木陸, 池野順一 (埼玉大学)</p>
15:20	<p>C10 AFMによる光ファイバ端面のナノ・マイクロ加工 第5報 —加工における触針材質および雰囲気の影響— 志関真生, 松井伸介 (千葉工業大学)</p>	<p>D10 レーザ照射によるガラス内部における金属球のマニピュレーションに関する研究 西岡直泰, 比田井洋史, 松坂社太, 千葉 明, 森田 昇 (千葉大学)</p>
15:40	<p>C11 強制振動モードAFM機構を用いたナノスケール加工実験 出井大裕, 田中雄大 (筑波大学), 芦田 極 (産業技術総合研究所), 藪野浩司 (筑波大学)</p>	<p>D11 フォトリソグラフィジェットを利用したレーザ微細加工に関する研究 —ビームの位置制御による加工量の高分解能制御— 上野原 努, 高谷裕浩, 水谷康弘 (大阪大学)</p>
16:00	***** 休憩 *****	
16:20	<p>【先端加工】(森田 昇, 吉野雅彦, 川塚宣隆) 座長: 芦田 極 (産業技術総合研究所) C12 サファイアの切削加工に及ぼす材料異方性の影響 沈 浩, 寺野元規, 吉野雅彦 (東京工業大学)</p>	<p>【光・ビームによる加工技術(2)】 座長: 池野順一 (埼玉大学) D12 加工プロセスモニタに基づくレーザ焼入れフォーミング現象の考察 織田良輔, 広田知直, 真鍋裕輝, 廣垣俊樹, 青山栄一 (同志社大学)</p>
16:40	<p>C13 ケミカルプリントによる超微細構造の作製 Potejana Potehanasak, 寺野元規, 吉野雅彦 (東京工業大学)</p>	<p>D13 極小刃物の高度化のためのレーザ焼入れ後刃形創製法に関する研究 須田晃平, 小川圭二 (龍谷大学), 田邊裕貴, 山本修平 (滋賀県立大学), 中川平三郎 (中川加工技術研究所)</p>
17:00	<p>C14 固体イオン交換法を利用したガラス内部への金属層形成 青山拓樹, 松坂社太, 比田井洋史, 千葉 明, 森田 昇 (千葉大学)</p>	<p>D14 金属粉末積層造形によるポーラス電極を用いた放電加工 小谷野智広, 井草良太, 古本達明, 細川 晃, 橋本洋平 (金沢大学)</p>
17:20	***** 休憩 *****	
17:30	<p>学会活性化フォーラム「姫路城から次世代ものづくりを学ぶ」 講演:「姫路城はこうしてできた—先端の思想と技術」(講堂) 17:30~19:00 播磨学研究所長/兵庫県立大学 特任教授 中元孝迪 氏</p>	
20:30	交流会(生協食堂) 19:00~20:30	

2016年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2016)

第2日目(9月1日) (*セッション名後はオーガナイザ名)

	A室	B室
9:00	<p>【難削材・新素材の加工(1)】 (静 弘生, 太田 稔, 北嶋孝之) 座長: 静 弘生 (静岡大学) A15 ガラス樹脂積層材切削用のPCD小径エンドミルの開発 内山文宏 (内山刃物), 松村 隆 (東京電機大学), 楠本利行, 坪井昭彦 (光産業創成大学院大学)</p>	
9:20	<p>A16 コーティング工具によるCFRPの切削加工におけるドライアイスパウダの影響 堀内拓実, 北嶋孝之, 由井明紀 (防衛大学校), 中村浩人 (サンエ機), 竹内 彰 (アストロテック)</p>	<p>【超音波・振動援用加工(1)】 (神 雅彦, 今井健一郎, 鈴木教和) 座長: 今井健一郎 (神奈川工科大学) B16 超音波高速切削における工具振動方向と切削チップ形状の影響 原 圭祐 (一関工業高等専門学校)</p>
9:40	<p>A17 単結晶ダイヤモンド工具によるSiCウエハの微細加工に関する基礎的研究 阿部 涉, 北嶋孝之, 由井明紀 (防衛大学校), 角谷 均, 原野佳津子 (住友電気工業)</p>	<p>B17 超音波振動を援用した小径ドリル加工 —第2報: ドリル食いつき時の切削抵抗挙動について— 米山 陽, 石黒輝雄, 佐野正明 (山梨県工業技術センター), 清水 毅 (山梨大学)</p>
10:00	<p>A18 PCDの高速定圧研削に関する研究 —加工能率に影響を与える因子— 中村篤史, 藤本剛壮, 岡崎文哉, 太田 稔, 江頭 快, 山口桂司 (京都工芸繊維大学), 三輪紘敬 (日産自動車), 中村暢秀 (アライドダイヤモンド)</p>	<p>B18 金属加工用超音波振動切削鉋 (かんな) の試作 神 雅彦, 飯塚卓也 (日本工業大学)</p>
10:20	<p>A19 紫外光支援によるダイヤモンド円弧内面の表面仕上げ 三輪紘敬 (日産自動車), 片木貴好 (富士重工業), 太田 稔, 山口桂司, 江頭 快 (京都工芸繊維大学), 南部俊和 (日産自動車)</p>	<p>B19 3D超音波援用加工による加工特性の検証 嶋田慶太 (東北大学), 岩立 龍 (ファナック), 水谷正義, 厨川常元 (東北大学)</p>
10:40	***** 休憩 *****	
11:00	<p>【難削材・新素材の加工(2)】 座長: 太田 稔 (京都工芸繊維大学) A20 チタン合金切削加工における油滴挙動に着目した高潤滑水溶性切削油剤の開発 杉原達哉, 藤原航太, 榎本俊之 (大阪大学), 山本修太郎, 山本 敬, 向恭平 (ネオス)</p>	<p>【超音波・振動援用加工(2)】 座長: 原 圭祐 (一関工業高等専門学校) B20 超音波振動を援用したアルミセラミックスの延性モード研削加工 米谷宇人, 今井健一郎 (神奈川工科大学)</p>
11:20	<p>A21 スローアウェイエンドミルによるチタン合金の溝切削において切削環境が工具寿命に与える影響 竹上 学, 児玉紘幸, 奥田孝一, 布引雅之 (兵庫県立大学)</p>	<p>B21 超音波振動援用研削によるCFRPの高精度溝加工 山崎剛史, 間 紀旺 (慶應義塾大学)</p>
11:40	<p>A22 純鉄系軟磁性材料の切削特性に関する研究 静 弘生, 酒井克彦, 河原彩音, LAM THI SANG (静岡大学)</p>	<p>B22 レプリカ転写法による微小穴の円筒形状評価 —ガラス穴を超音波援用研削加工で形成した場合— 小川昭, 高橋武則, 平林隆一 (目白大学), 樋口英一 (東京都立産業技術研究センター)</p>
12:00	<p>A23 放電加工変質層を持つ超硬合金切削における工具材種の影響 中西亘介, 宮本 猛 (神戸市立工業高等専門学校)</p>	<p>B23 超音波振動援用によるホーニング加工面の表面性状 水谷秀行 (中部大学)</p>
12:20	***** 昼食 *****	
13:20	<p>台湾磨粒加工学会 招待講演 (A棟401室) 「Progress in Precision Machining of Difficult-to-Machine Materials」 台湾磨粒加工学会 Professor, Dr. Choung-Lii CHAO (Tam-Kang University)</p>	
14:20	***** 休憩 *****	
14:40	<p>特別講演 (A棟401室) 「Spring-8と顕微分光」 公益財団法人高輝度光科学研究センター利用推進部 部長 (兼)利用研究促進部門 主席研究員 (Spring-8) 木下豊彦 氏</p>	
15:40	***** 休憩 *****	
16:00	<p>活動報告会・贈賞式 (A棟401室)</p>	
17:20	***** 移動 *****	
18:00	<p>懇親会 (灘菊酒蔵 酒蔵の膳処 西蔵)</p>	
20:00		

2016年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2016)

第2日目(9月1日) (*セッション名後はオーガナイザ名)

	C室	D室
9:00	<p>【ナノ精密・ELID加工】(水谷正義, 大森 整, 伊藤伸英, 片平和俊) 座長: 水谷正義 (東北大学) C15 PELIDを用いたファイバー積層砥石の開発 塚田並輝, 伊藤伸英 (茨城大学), 大森 整, 加藤照子 (理化学研究所), 梅津信二郎 (早稲田大学)</p>	<p>【切断・割断加工】(諏訪部 仁, 山田高三, 水野雅裕, 松坂壮太) 座長: 山田高三 (日本大学) D15 電着ダイヤモンドワイヤにおけるダイヤモンド砥粒の分散状態と加工能率の関係 橋本賢樹, 佐野 弘 (福井県工業技術センター), 小泉将治 (アイテック)</p>
9:20	<p>C16 PELIDとグリーンシートを用いた植物由来カーボン含有積層砥石の開発 樋渡大樹, 伊藤伸英, 山田 希, 山崎和彦 (茨城大学), 大森 整 (理化学研究所), 梅津信二郎 (早稲田大学)</p>	<p>D16 樹脂コーティングワイヤを用いたマルチワイヤソーにおける加工部の砥粒挙動 佐治季貴, 諏訪部 仁, 石川憲一 (金沢工業大学)</p>
9:40	<p>C17 マイクロバブル含有研削液を用いたELID研削技術 山本寛之 (茨城大学), 稲澤勝史 (栃木県産業技術センター), 伊藤伸英 (茨城大学), 大森 整, 加藤照子 (理化学研究所)</p>	<p>D17 マルチワイヤソーによるSiCの高精度スライシング加工に関する研究 大久保順平, 諏訪部 仁, 石川憲一 (金沢工業大学)</p>
10:00	<p>C18 高硬度鉄めっき砥石の開発とその加工特性 大野椋平, 伊藤伸英 (茨城大学), 大森 整, 加藤照子 (理化学研究所), 松澤 隆 (池上金型工業), 稲澤勝史 (栃木県産業技術センター)</p>	<p>D18 偏光高速度カメラによる薄板ガラスのホイール割断時の位相差計測 長谷川良平, 松坂壮太, 比田井洋史, 千葉 明, 森田 昇 (千葉大学)</p>
10:20	<p>C19 レーザー照射による使用済みガラス用研磨材からの酸化セリウムの回収の試み 茂木俊樹 (ものづくり大学), 加藤照子, 大森 整 (理化学研究所), 小泉俊郎 (メガオプト), 上原嘉宏, 渡邊 剛 (理化学研究所), 堀内 勉 (ものづくり大学)</p>	<p>D19 硬脆性材料の新切断加工 北市 充, 村上健二, 留井直子, 平野茂和, 長友正平, 福西利夫 (三星ダイヤモンド工業)</p>
10:40	***** 休憩 *****	
11:00	<p>【半導体・液晶材料などの加工・計測技術】(周 立波, 畝田道雄) 座長: 吉富健一郎 (防衛大学校) C20 紫外線励起加工の研究 (第21報) —紫外線励起下における4H-SiCウエハの研磨特異性(その2)— 田中武司, 滝沢優, 畑彰宏 (立命館大学)</p>	<p>【噴射・バレル加工の最前線(1)】(深川 仁, 嶋田慶太, 曙 紘之) 座長: 曙 紘之 (広島大学) D20 微粒子ピーニングおよびプラズマ溶射によりハイドロキシアパタイト層を被覆したβ型チタン合金の疲労特性 青木達兵, 中村裕紀, 清水利弘 (豊田工業高等専門学校), 菊池将一 (神戸大学), 南部紘一郎 (鈴鹿工業高等専門学校), 赤堀俊和 (名城大学)</p>
11:20	<p>C21 Siウエハのロータリ研削における延性・脆性モードに関する研究 楠山純平, 北嶋孝之, 由井明紀 (防衛大学校), 伊東利洋 (岡本工作機械製作所)</p>	<p>D21 微粒子ピーニングによるTi-6Al-4V合金へのハイドロキシアパタイト層の創製とその4点曲げ疲労特性 菊池将一 (神戸大学), 中村裕紀 (豊田工業高等専門学校), 南部紘一郎 (鈴鹿工業高等専門学校), 赤堀俊和 (名城大学)</p>
11:40	<p>C22 切込機構内蔵砥石スピンドルを用いたシリコンウエハの揺動研削に関する研究 藪野真大, 岩橋伸太郎, 楠山純平, 北嶋孝之, 由井明紀 (防衛大学校), 伊東利洋 (岡本工作機械製作所), A. H. Slocum (Massachusetts Institute of Technology)</p>	<p>D22 ステンレス鋼のバイオフィルム形成におよぼす微粒子ピーニングの影響 菅原 輝, 南部紘一郎 (鈴鹿工業高等専門学校)</p>
12:00	<p>C23 単一固定砥粒工具による粗面ガラスの鏡面加工プロセス 上村康幸, 土屋健介 (東京大学生産技術研究所)</p>	<p>D23 パウダージェットデポジション (PJD) における粒子破碎挙動と成膜メカニズムに関する研究 水谷正義, 久慈千栄子, 大久洋幸, 西村俊亮, 水谷公一, 徐 少林, 嶋田慶太, 赤塚 亮, 厨川常元 (東北大学)</p>
12:20	***** 昼食 *****	
13:20	<p>台湾磨粒加工学会 招待講演 (A棟401室) 「Progress in Precision Machining of Difficult-to-Machine Materials」 台湾磨粒加工学会 Professor, Dr. Choung-Lii CHAO (Tam-Kang University)</p>	
14:20	***** 休憩 *****	
14:40	<p>特別講演 (A棟401室) 「Spring-8と顕微分光」 公益財団法人高輝度光科学研究センター利用推進部 部長 (兼)利用研究促進部門 主席研究員 (Spring-8) 木下豊彦 氏</p>	
15:40	***** 休憩 *****	
16:00	<p>活動報告会・贈賞式 (A棟401室)</p>	
17:20	***** 移動 *****	
18:00	<p>懇親会 (灘菊酒蔵 酒蔵の膳処 西蔵)</p>	
20:00		

2016年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2016)

第3日目(9月2日) (*セッション名後はオーガナイザ名)

A室		B室	
9:00	<p>【環境調和型加工技術(1)】 (二ノ宮進一, 大西 孝, 西川尚宏) 座長: 岩井 学 (富山県立大学) A24 ナノファイバー不織布の製造とその研磨加工への応用 呉魏, 青山栄一, 廣垣俊樹 (同志社大学), 池ヶ谷守彦, 越前谷孝嗣, 曾田浩義 (エム・テックス)</p>	<p>【超砥粒砥石・高機能工具の開発と応用(1)】 (澁谷秀雄, 澤 武一, 山口桂司) 座長: 澁谷秀雄 (久留米工大) B24 超砥粒ビトリファイドボンドホイールによる大口径単結晶SiC研削 網野修一, 石津智広, 中村暢秀, 高橋利也 (アライドマテリアル)</p>	
9:20	<p>A25 アルミナセラミックスのMQL研削加工 —ダイヤモンド軸付砥石を用いた形状創成における、研削速度の影響— 横山 正, 友田賢志 (ヘインテクノベルク), 今田琢巳 (滋賀県工業技術総合センター), 中川平三郎 (中川加工技術研究所)</p>	<p>B25 超砥粒ビトリファイドボンドホイールによる単結晶LiTaO₃ウェーハ研削 石津智広, 網野修一, 中村暢秀, 高橋利也 (アライドマテリアル)</p>	
9:40	<p>A26 石炭火力発電用パネル式ボイラ水冷壁管の補修のためのタンデム研削の開発 土屋俊一, ニノ宮進一 (日本工業大学), 白石陽一 (ウェルディングアロイズ・ジャパン)</p>	<p>B26 高性能ビトリファイドCBNホイール向け新ガラス結合剤の開発 中井太一, 今池浩史, 諸戸隆幸 (豊田バンモップス)</p>	
10:00	<p>A27 無酸化雰囲気による超硬合金および鉄鋼材料の同時研削加工に関する研究 塩島亜木斗, 古賀文雄, ニノ宮進一 (日本工業大学)</p>	<p>B27 SiCのUVアシスト固定砥粒研磨法の開発 小辻利幸, 石橋嵩洋, 太田 稔, 江頭 快, 山口桂司 (京都工芸繊維大学), 山田正良, 糸井正弘 (日進製作所)</p>	
10:20	***** 休憩 *****		
10:40	<p>【環境調和型加工技術(2)】 座長: ニノ宮進一 (日本工業大学) A28 強アルカリイオン水による除去加工の研究 —第4報: 加工抵抗への影響— 岩井 学 (富山県立大学), 山田雅英 (山田マシンツール), 鈴木 清 (鈴木清新加工技術研究所)</p>	<p>【超砥粒砥石・高機能工具の開発と応用(2)】 座長: 大西孝 (岡山大学) B28 鉄道レールの全断面削正装置の開発 —第1報: アーム型手動削正装置の開発— 鈴木紀彦, 佐竹宣章, (JR東日本), 今野啓輝, 小松良知 (大研工業), 阿部貞雄 (軌道技研), 梅田 勉, 須賀久隆 (ノリタケカンパニーリミテド), 家口 心 (宮城県産業技術総合センター)</p>	
11:00	<p>A29 強アルカリイオン水による除去加工の研究 —第5報: ナノカーボン粒子混入の効果— 岩井 学, 細江 拳 (富山県立大学), 山田雅英 (山田マシンツール), 森田修司 (研削研磨), 鈴木 清 (鈴木清新加工技術研究所)</p>	<p>B29 鉄道レールの全断面削正装置の開発 —第2報: 手動削正装置による常温レールの削正試験— 佐竹宣章, 鈴木紀彦 (JR東日本), 今野啓輝, 小松良知 (大研工業), 阿部貞雄 (軌道技研), 梅田 勉, 須賀久隆 (ノリタケカンパニーリミテド), 家口 心 (宮城県産業技術総合センター)</p>	
11:20	<p>A30 電気防錆加工システムの開発研究 —水加工性能と実用化への過程— 西川尚宏 (岩手大学), 澤 武一 (芝浦工業大学), 萩原義裕, 吉原信人, 大川井宏明, 水野雅裕 (岩手大学), 塚本真也 (中国職業能力開発大学校)</p>	<p>B30 鉄道レールの全断面削正装置の開発 —第3報: 手動削正装置による高温レールの削正試験— 家口 心 (宮城県産業技術総合センター), 鈴木紀彦 (JR東日本), 今野啓輝, 小松良知 (大研工業), 阿部貞雄 (軌道技研), 梅田 勉, 須賀久隆 (ノリタケカンパニーリミテド), 佐竹宣章 (JR東日本)</p>	
11:40	***** 休憩(10分) *****		
11:50	奨励賞受賞記念講演 (A棟401室)		
12:10	***** 昼食 *****		
13:10	<p>【先進切削加工技術(1)】 (関根 務, 小川圭二, 宮本 猛, 杉原達哉) 座長: 杉原達哉 (大阪大学) A31 赤外線サーモグラフィと無線多機能ホルダによるワイヤレスな回転切削工具の加工現象 松田 亮, 新堂正俊 (山本金属製作所), 廣垣俊樹, 青山栄一 (同志社大学), 古木辰也 (岐阜大学)</p>	<p>【磁界・電界砥粒制御による次世代加工技術】 (川久保英樹, 鄒 艶華, 呉 勇波) 座長: 川久保英樹 (信州大学), 久住孝幸 (秋田県産業技術センター) B31 研磨スラリーの電界活性化技術 久住孝幸 (秋田県産業技術センター), 池田 洋 (秋田工業高等専門学校), 越後谷正見, 中村竜太, 赤上陽一 (秋田県産業技術センター)</p>	
13:30	<p>A32 マシニングセンタのヘリカル補間運動を用いた高硬度焼入れ鋼のネジ切り加工法 松井翔太 (大和歯車製作), 古木辰也 (岐阜大学), 廣垣俊樹, 青山栄一 (同志社大学)</p>	<p>B32 電界スラリー制御技術を適用した高効率CMP技術の開発 池田 洋, 羽柴 麗, 藤井優和, 泉 泰秀 (秋田工業高等専門学校), 久住孝幸, 中村竜太, 赤上陽一 (秋田県産業技術センター)</p>	
13:50	<p>A33 ラジラスエンドミル加工における工具経路間隔の三次元幾何学的考察 関根 務 (東海大学)</p>	<p>B33 電解還元水スラリーを用いた磁気援用加工法 —加工メカニズムの考察— 川久保英樹, 佐藤運海 (信州大学), 村田修一 (長野県工科短期大学校)</p>	
14:10	<p>A34 3次元空間におけるハンドマトリックスの数式表現 —技術感性の理解のために— 日比野 隼, 関根 務 (東海大学)</p>	<p>B34 磁場制御による平面および凹面に対する精密研磨特性 西田 均 (富山高専専門学校), 島田邦雄 (福島大学), 井門康司 (名古屋工業大学)</p>	
14:30	***** 休憩 *****		
14:50	<p>【先進切削加工技術(2)】 座長: 関根 務 (東海大学) A35 単結晶ダイヤモンドバイトによるナノスケール微細軸加工 高野英亮, 栗山健一, 江頭 快, 山口桂司, 太田 稔 (京都工芸繊維大学)</p>		
15:10	<p>A36 ニッケルチタン合金の小径エンドミル加工 浜口和也 (兵庫県立工業技術センター), 児玉紘幸, 奥田孝一 (兵庫県立大学)</p>		
15:30			
15:50			

2016年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2016)

第3日目(9月2日) (*セッション名後はオーガナイザ名)

	C室	D室
9:00	<p>【超精密加工装置の開発と超精密加工技術】(鈴木浩文, 福田将彦, 森田晋也) 座長: 山口桂司(京都工芸繊維大学) C24 形彫り放電加工による難加工材のマイクロ加工 岡田 睦, 鈴木浩文, 秋山裕亮(中部大学), 深見信吾, 末吉知力也, 清水謙一(日本タングステン), 増沢隆久(増沢マイクロ加工技術コンサルティング)</p>	
9:20	<p>C25 超精密シェーパ加工に起因する中間周波数形状誤差の除去のための修正研磨法の検討 細島拓也, 竹田真宏, 河合利秀(理化学研究所), 森田晋也(東京電機大学), 山形 豊(理化学研究所)</p>	<p>【噴射・バレル加工の最前線(2)】 座長: 深川 仁(岐阜大学) D25 流動バレル研磨法における流動特性に関する研究 山本章裕(兵庫県立工業技術センター), 松本有司, 山口智実, 北嶋弘一(関西大学)</p>
9:40	<p>C26 超精密加工機へのタッチプローブ搭載に関する検討 田邊耕平, 福田将彦(東芝機械)</p>	<p>D26 AIH-FPP処理によるTi合金表面のTi-Al金属間化合物化プロセスの検討 齋藤周也, 武末翔吾, 小茂鳥 潤(慶應義塾大学)</p>
10:00	<p>C27 砥石面のトライボロジー特性の検討 林 偉民(群馬大学)</p>	<p>D27 斜投射微粒子ピーニングによる微細周期構造の形成およびその大面積化 伊藤佑介, 亀山雄高, 佐藤秀明, 眞保良吉(東京都市大学), 大森 整(理化学研究所)</p>
10:20	***** 休憩 *****	
10:40	<p>【新デバイスへの応用(1)】(亀山雄高, 矢澤孝哲) 座長: 亀山雄高(東京都市大学) C28 チタン材料の腐食と摩耗特性に及ぼす表面テクスチャリングの影響 上村拓也(上智大学), 水谷正義(東北大学), 久森紀之(上智大学)</p>	<p>【噴射・バレル加工の最前線(3)】 座長: 嶋田慶太(東北大学) D28 プラストを利用したCFRPの切断加工法の開発 深川 仁, 市川大稀, 齋藤沙織(岐阜大学)</p>
11:00	<p>C29 脊椎インプラントデバイスのロープロファイル化の検討 岩出拓人, 久森紀之(上智大学), 藤田淳一, 山谷健治(ミズホ)</p>	<p>D29 プラスト加工に用いる再利用可能なマスク材料の検討 深川 仁, 西川幸佑(岐阜大学)</p>
11:20	<p>C30 Al(NO₃)₃溶液ミストを用いたレーザー誘起湿式改質法によるSUS316L鋼の表面改質 江面篤志, 大川弘暉(慶應義塾大学), 片平和俊(理化学研究所), 小茂鳥 潤(慶應義塾大学)</p>	<p>D30 バリ取り加工におけるブラシ押しつけ力に基づくブラシ摩耗度合の評価に関する研究 畑野 巧, 布引雅之, 奥田孝一, 児玉紘幸(兵庫県立大学), 山角 寛(川重テクノロジー)</p>
11:40	***** 休憩(10分) *****	
11:50	奨励賞受賞記念講演 (A棟401室)	
12:10	***** 昼食 *****	
13:10	<p>【新デバイスへの応用(2)】 座長: 片平和俊(理化学研究所) C31 人工歯加工メカニズム解析に関する研究 — エアタービンハンドピースによる加工特性の評価 — 丸木諒祐, 矢澤孝哲(長崎大学), 土肥 学(デンタルワークス), 野崎悠輔(長崎大学), 森山慎也(三井ハイテック)</p>	<p>【噴射・バレル加工の最前線(4)】 座長: 西川尚宏(岩手大学) D31 ショットライニング加工によるMg合金の新しい表面改質 松本 実, 原田泰典(兵庫県立大学)</p>
13:30	<p>C32 歯科用複合レジン乾式研磨 — アルギン酸ナトリウム軸付き砥石の開発 — 岩井優紀, 佐藤秀明(東京都市大学), 山下哲二(メゾテクダイヤ), 亀山雄高, 眞保良吉(東京都市大学), 加藤喬大, 田中秀和(山本貴金属地金)</p>	<p>D32 ショットライニング熱処理法によるアルミニウム合金の表面改質 原田泰典, 松本 実, 布引雅之(兵庫県立大学), 高橋勝彦(富山高専専門学校)</p>
13:50	<p>C33 サンドブラスト処理を施した金属表面への細胞接着性評価 桃沢 愛, 斉藤 学, 大森系織絢, 亀山雄高(東京都市大学)</p>	<p>D33 Ti-6Al-4V合金の疲労特性に及ぼすショットピーニングの影響 佐伯優斗, 原田泰典(兵庫県立大学), 服部兼久, 渡邊吉弘(東洋精鋼)</p>
14:10		<p>D34 難燃性マグネシウム合金の表面特性に及ぼすピーニング効果 田中幸平, 佐伯優斗, 原田泰典(兵庫県立大学)</p>
14:30	***** 休憩 *****	
14:50		<p>【噴射・バレル加工の最前線(5)】 座長: 布引雅之(兵庫県立大学) D35 ばね鋼の疲労強度に及ぼすマイクロショットピーニングの影響 原田泰典, 佐伯優斗, 田中秀星(兵庫県立大学)</p>
15:10		<p>D36 ばね鋼の疲労強度に及ぼす超音波ショットピーニングの影響 原田泰典, 佐伯優斗(兵庫県立大学), 服部兼久, 渡邊吉弘(東洋精鋼)</p>
15:30		<p>D37 超音波ピーニングおよびマイクロショットピーニングによるステンレス鋼の疲労強度改善 原田泰典, 佐伯優斗, 芝崎和馬(兵庫県立大学)</p>
15:50		